



SAC305

ALLIAGE S-Sn96,5 Ag3,0 Cu0,5

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alliage de brasage ternaire sans plomb, utilisé dans l'industrie électronique mais aussi dans des applications médicales et alimentaires.

- * Le plus bas joint de fusion des alliages sans plomb habituels : 217°C.
- * Alliage le plus utilisé parmi les sans plomb ternaires SAC (SnAgCu) sur le plan international
- * Très bonne résistance mécanique.
- * Alliage brillant, bonne capillarité.
- * Bonne conductibilité électrique.
- * Bon mouillage sur les surfaces habituelles, mais limitée sur Cu.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Teneur Étain, Sn :	Restant
Teneur Cuivre, Cu :	0.2 % à 0.6 %
Teneur Argent, Ag :	3,0 % à 3,4 %
Intervalle de fusion :	Eutectique à 217°C
Masse spécifique :	7.3
Résistance mécanique :	Dureté Brinell : 14.8 H.B.
Conductibilité électrique :	14 % IACS
Résistivité électrique :	12.3 $\mu \Omega$ cm

ASSURANCE QUALITÉ

Chaque livraison est identifiée par son lot de fabrication muni du certificat d'analyse correspondant.

Composition chimique correspondant à celle de stocks disponibles à la date de l'édition et pouvant être sujette à modification. Ces teneurs ne sont qu'indicatives et ne sauraient engager contractuellement TELAMETAL